



In den Gruppenäckern 2
Neustadt an der Orla, Thüringen 07806
Deutschland

Telefon: 036481 / 595-0

Mit einem funktionierenden Qualitäts- und Umweltmanagementsystem, das die Anforderungen nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 erfüllt, sichern wir die Einhaltung aller qualitäts- und umweltbezogenen Maßnahmen, die zur Herstellung unserer Erzeugnisse getroffen wurden. Die Umsetzung unserer Strategie verfolgen wir durch sachgerechte Information und gezielte Schulung unserer Mitarbeiter und die Festlegung klarer Zuständigkeiten. Überhaupt legen wir sehr großen Wert auf die Motivation der Mitarbeiter, die auch durch die Beteiligung am Erfolg unserer Erzeugnisse mittels gerechter Entlohnung gefördert wird. Die Zufriedenheit, der Teamgeist und die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter bilden die Voraussetzung für ein gutes Betriebsklima. Das alles im Einklang mit dem Einsatz modernster Technik und dem Know-how aufgrund langjähriger Erfahrung bei der Produktion von Leiterplatten läßt hochwertige Erzeugnisse entstehen. Technologie Multilayer

Ein Multilayer besteht aus mehr als zwei elektrisch leitfähigen Lagen, die fest zu

einer Leiterplatte verbunden sind. Der Standardaufbau erfolgt mit dem Kern (K) mit beidseitiger Kupferschicht. Darauf folgen die Prepregs (P) als Isolation und Träger der abschließenden Kupferfolie (F) für die Außenlagen oder weiterer Kerne. Durch die Wahl des Aufbautyps können bei gleicher Lagenanzahl unterschiedliche Kontaktierungs-möglichkeiten bei optimalen oder maximalen technologischen Grenzen erreicht werden. Aber auch der Fertigungsaufwand und letztendlich die Kosten werden hierdurch beeinflusst. Der Standardaufbau eines Multilayer bei EPN besteht aus innen liegenden Kernen bei symmetrischem Aufbau. Multilayer bis 16 Lagen bei Endstärken von maximal 3.20mm sind möglich. Die minimale Leiterplattenendstärke hängt von der Lagenanzahl und den Aufbauparametern ab. Ein individueller Aufbau kann nach Rücksprache möglich sein. Dabei sind neben den Aufbauparametern auch Bedingungen wie blind Vias oder Impedanzanforderungen abzuklären. Als Basis dienen die Toleranzen unserer Hausnorm. Unsere Mitarbeiter beraten Sie diesbezüglich gern und kompetent. Dickkupfer Leiterplatten

Wir haben Erfahrungen mit Kupferendstärken bis circa 175 µm. Wichtigste Voraussetzung ist die angemessene Anpassung der Leiterbahnbreiten und Abstände sowie ausreichende Restringe bei einsprechenden Lochdurchmessern. Bei größeren Endstärken sind wir gern bereit, das Produkt in Kooperation mit dem Kunden zu entwickeln. Oberflächen Die lötfähigen Endoberflächen unserer Leiterplatten werden durch chemische Abscheidungsprozesse oder Heißluftverzinnen - Hot Air Levelling (HAL) erzeugt. chemisch Zinnchemisch Nickel Gold (ENIG) HAL Drucke Lötstopmmaske Standard ist eine wässrig, alkalisch entwickelbare, fotosensible grüne Lötstopmmaske, die im Vorhanggießverfahren aufgebracht wird. Auf Kundenwunsch setzen wir häufig andere handelsübliche Farben, wie rot, blau, weiß deckend oder schwarz in den Ausführungen matt bis glänzend ein. Bestückungsdrucke Für den Bestückungsdruck setzen wir standardmäßig die Farben schwarz, gelb und weiß der Firma Coates ein, da diese

unbedingt kompatibel zum Lacksystem sein müssen. Andersfarbige Bestückungsdrucke sind auf Nachfrage ebenso erhältlich. Carbonleitlack

Dieser Lack ist neben der Anwendung für Taster aufgrund seiner sehr glatten Oberfläche auch für Schleifkontakte geeignet. Dieser Lack hat den Vorteil, dass er im HAL-Prozeß stabil ist. Durchsteigerfüller

Der Druck des Durchsteigerfüllers dient dem sicheren Verschließen der Via - Bohrungen. Es verhindert das Durchsteigen von Lötzinn auf die Bauteilseite und das Festsetzen von Flußmitteln in den Bohrungen. Je nach technologischer Anforderung setzen wir bestimmte Lacke ein. Abdecklack

Lötabdecklack oder abziehbare Lötstopplacke werden zum partiellen Abdecken von Leiterplatten als Schutz vor direktem Kontakt mit dem Lot beziehungsweise Schutz vor galvanischen Prozessen gedruckt. Sie haben eine sehr hohe Einreißfestigkeit und Elastizität und lassen sich nach dem Lötprozeß einfach entfernen.

[Website besuchen](#)
[Anfrage senden](#)
[Eintrag weiterleiten](#)

